

*Plasma Chemical Vaporization Machining*

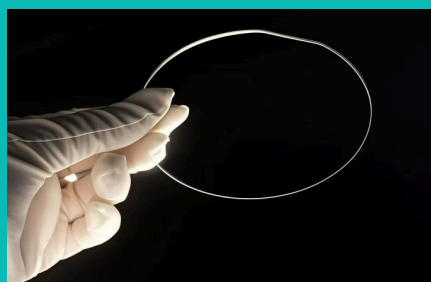
**等离子体化学气相加工机 PCVM**



**无产生加工变质层**

**数控加工节能环保**

**膜厚分布表面平滑化机**

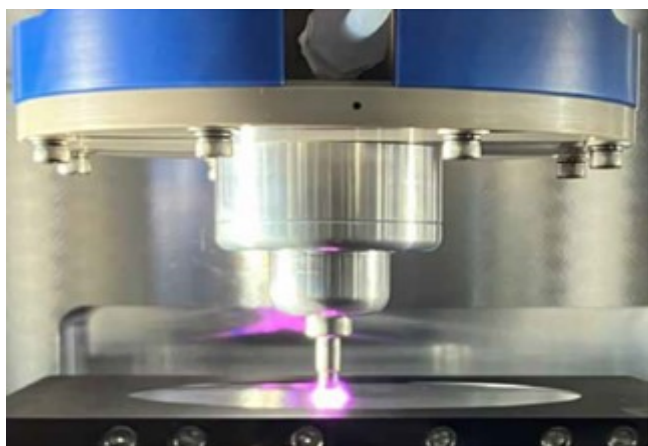


**石英衬底**

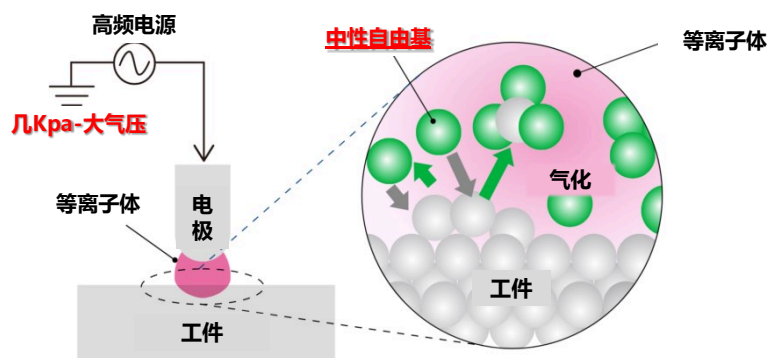


**SOI衬底**

## 加工平台



## 加工原理

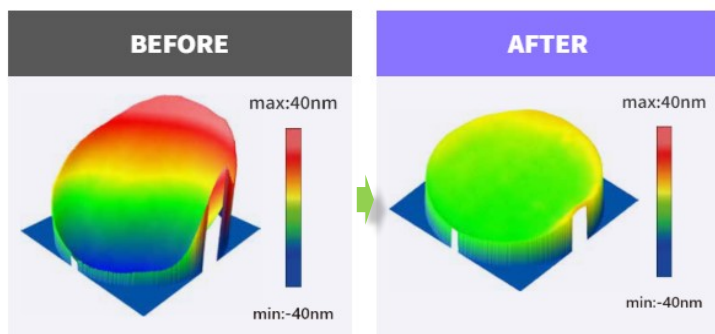


## 加工案例

### 石英晶片 (水晶)

尺寸 ; 4英寸 (100mm)

测试范围; 直径100mm晶圆内领域



加工前厚度分布  
TTV; 102nm

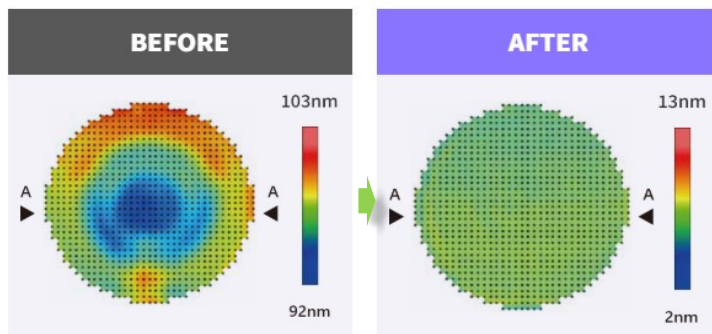
加工后厚度分布  
TTV; 18nm

### SOI晶圆 (绝缘体上单晶硅薄膜)

尺寸 ; 8英寸 (200mm)

SOI层 ; 100nm, 埋入氧化膜层; 200nm

测试范围; 直径190mm晶圆内领域, 5.5mm格子



加工前SOI层厚度  
平均膜厚; 97.5nm  
TTV ; 9.4nm

加工后SOI层厚度  
平均膜厚; 7.5nm  
TTV ; 3.0nm

